



## 新闻发布

### 安靠科技为多种应用提供光学封装解决方案

美国亚利桑那州坦佩当地时间 2018 年 12 月 3 日 - Amkor Technology, Inc. (纳斯达克: AMKR) , 一家领先的半导体封装和测试外包服务提供商公布其 MEMS 和传感器封装平台以应对光学市场不断高涨的需求。新的光学封装平台是我们大获成功的 ChipArray® BGA 和 MicroLeadFrame® 产品系列的衍生产品, 可被用于包括 LIDAR、指纹传感器、环境光线传感器和 3D 脸部识别在内的众多应用。

安靠科技企业副总裁 John Donaghey 表示: “安靠科技在制造与测试适用于汽车、通信和消费类应用的 MEMS 和传感器器件方面拥有超过 25 年的丰富经验。” 他还表示: “对于拓展大批量生产的 MEMS 和传感器封装平台, 从而满足光学市场的需求, 我们感到十分激动。这让我们的客户可以快速地将其解决方案推向市场, 而不用在性能方面做出妥协。”

Amkor 的工厂都通过 IATF16949 认证, 有能力满足 AEC-Q100 规格标准的苛刻要求。Amkor 的完整一站式光学 MEMS 和传感器解决方案包括设计、封装和测试。要更详细地了解 Amkor 在光学 MEMS 和传感器封装领域所具备的能力, 请访问 [www.amkor.com/technology/optical-sensors/](http://www.amkor.com/technology/optical-sensors/)。

#### **关于 Amkor Technology, Inc.**

Amkor Technology, Inc. 是全球最大的半导体封装和测试的外包服务供应商之一。它成立于 1968 年, 作为一直致力于半导体集成电路封装和测试外包的先驱者, 目前是 250 多家世界领先的半导体设计公司、晶圆厂和电子设备制造商的战略制造合作伙伴。安靠的运营基地占地面积 1,100 万平方英尺, 包括工厂、产品开发中心以及销售办公室, 其位于亚洲、欧洲和美国主要电子制造区域。如需更多信息, 请访问 [www.amkor.com](http://www.amkor.com)。

###



## 新闻发布

### 关键词

OSAT

半导体封装

先进 IC 封装

封装与测试

光学传感器封装

光学传感器测试

异构集成

MEMS

MOEMS

传感器

BGA

ChipArray®

MicroLeadFrame®

社交媒体: @amkortechology

### 联系人

投资者关系

Chris Chaney

副总裁, 投资者关系

480-786-7594

媒体关系

Debi Polo

高级经理, 营销沟通

480-786-7653